

证券简称：广合科技

股票代码：001389



广州广合科技股份有限公司

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

(广东省广州市黄埔区保税区保盈南路 22 号)

**向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二六年六月

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 释 义 | 2 |
| 第一节 本次募集资金使用计划 | 3 |
| 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况 | 4 |
| 一、云擎智造基地项目（二期） | 4 |
| 二、高多层产线技术改造项目 | 7 |
| 三、补充流动资金 | 10 |
| 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 13 |
| 一、本次向不特定对象发行可转债对公司经营管理的影响 | 13 |
| 二、本次向不特定对象发行可转债对公司财务状况的影响 | 13 |
| 第四节 可行性分析结论 | 14 |

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 广合科技、公司、发行人、上市公司 | 指 | 广州广合科技股份有限公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 发行、本次发行、本次向不特定对象发行可转债 | 指 | 广州广合科技股份有限公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的行为 |
| 本报告 | 指 | 广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 云擎智造基地项目（二期） | 198,359.09 | 185,000.00 |
| 2 | 高多层产线技术改造项目 | 155,992.17 | 100,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 合计 | | 429,351.26 | 360,000.00 |

在本次发行 A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

第二节 本次募集资金投资项目的具体情况

一、云擎智造基地项目（二期）

（一）项目概况

本项目拟投资 198,359.09 万元，拟使用本次向不特定对象发行 A 股可转债募集资金 185,000.00 万元。本项目拟购置高端 PCB 生产、检测及配套设备，扩大用于服务器领域的高多层板、高阶 HDI 板等产品的生产能力，满足行业技术升级需求，完善区域产能布局，增强公司综合竞争力。本项目由广合科技实施。

（二）项目实施的必要性

1、满足市场需求，扩大供应能力

当前人工智能与数字经济加速发展，全球算力基础设施建设全面提速，AI 服务器市场迎来高速增长。据 Trend Force 数据，2024 年全球 AI 服务器出货量较 2023 年增长 40%，达 165.5 万台，预计到 2026 年将增长至 241.3 万台，2022-2026 年复合增长率达 28.8%。AI 服务器产业的扩张，将大幅拉动高多层板、高阶 HDI 板等算力类 PCB 产品需求。

公司目前已在服务器领域完成一定的产品布局，如完成了搭载 PCIe 6.0 平台的高速主板产品的转批量能力，在数据中心交换机领域完成了 400G/800G 交换机 PCB 板的量产等。伴随下游头部客户采购需求持续放量，公司亟需加大资本与产能投入，进一步扩充供应能力，以匹配市场需求。本次项目建成后，公司将新增人工智能高阶 HDI、高多层板合计年产 11.15 万平方米的生产能力，可全面匹配行业规模化采购需求，助力公司抢抓算力产业发展红利，进一步提升高端算力 PCB 产品的市场占有率。

2、满足行业技术升级需求，提升柔性生产能力

作为电子信息产业的核心基础部件，印制电路板深度赋能人工智能、高性能计算、6G 通信、低轨卫星等前沿领域，行业技术迭代持续提速。尤其在 AI 服务器领域，算力与数据交互需求持续攀升，推动 PCB 向高层数、高集成、高速传输方向演进。面向人工智能的高端电路板，在叠层设计、精密加工、原材料选型、

长期可靠性等方面的管控标准远高于传统产品，行业技术升级诉求愈发迫切。与此同时，下游终端产品更新迭代速度加快，高多层板的叠层方案、层数配比、布线规格等产品参数呈现快速变化的特征，下游客户会基于产品迭代、硬件升级需求，频繁调整 PCB 设计方案，这对行业厂商的快速换线、产线灵活调配等柔性生产能力提出了更高要求。

公司深耕 PCB 制造领域多年，拥有成熟完备的生产体系与制造经验。但现有部分早期产线基于传统标准化大批量模式设计，设备与制程通用性有限，面对高端高多层板复杂工艺、频繁的规格调整需求时，产线换线效率不足，柔性调配能力存在提升空间，一定程度制约了高端产品拓展与业务规模增长。本次项目拟引进先进工艺设备与精密检测设备，一方面可全面匹配行业高端制造与技术升级要求，夯实高端产品制造能力；另一方面将大幅提升产线快速换线与柔性调配水平，从容应对客户产品规格快速变更的需求，全面强化综合生产竞争力。

3、完善产能布局，提升竞争能力

公司深耕高端 PCB 领域多年，已形成广州、黄石两大国内生产基地及泰国海外生产基地的全球化产能布局体系，并同步推进云擎智造基地一期建设落地。公司国内两大生产基地既可为海外客户供货，产品远销东南亚、欧洲、美洲等区域，同时也可满足国内市场的生产交付需求，已具备较为稳定的全球化供货与交付保障能力。

近年来，全球算力产业蓬勃发展，促进高端服务器市场持续扩容，高端算力 PCB 产品市场需求空间亦进一步扩大。受现有生产基地布局限制，公司无法充分抢抓广阔的算力 PCB 市场发展机遇，产能布局仍存在不足，市场服务能力有待进一步提升。本项目的实施能够有效优化订单交付效率，补强生产及技术服务能力，增强公司在高端算力 PCB 领域的综合竞争力。

（三）项目实施的可行性

1、市场前景广阔，项目实施具备良好的市场基础

算力、通信等下游产业持续景气，有效拉动全球及国内 PCB 产品需求稳步扩张。从行业整体市场规模来看，根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 市场规

模将达到 848.91 亿美元，中国大陆 PCB 市场规模同步攀升至 493.54 亿美元，预计 2029 年全球 PCB 市场规模将增至 1,091.58 亿美元，中国大陆 PCB 市场规模有望达到 620.26 亿美元，行业整体增长动能强劲。从下游细分领域来看，算力基础设施建设将促进 PCB 细分市场结构优化，服务器/数据存储类 PCB 产品增长表现突出。根据 Prismark 数据，2025 年该类产品全球市场规模为 159.75 亿美元，增速为 46.3%，预计 2029 年市场规模将达 257.29 亿美元，增长动力来自 AI 服务器升级与数据中心设备扩容。在人工智能服务器及高速网络需求带动下，HDI 板及高层数多层板等高端产品占比将持续提升，行业逐步向高层数、高频高速及高可靠性方向发展。综上，行业及下游应用广阔的市场前景，为本项目顺利实施奠定市场基础。

2、项目实施具备坚实的技术支撑

公司为国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、广东省高频高速印制线路板等多个省级研发平台，下设专业研究院，搭建材料应用与研究实验室、产品研发组、创新工艺研究组等研发单元。依托强大研发实力，公司已成功打造适配 GPU 主板、阶梯 HDI 服务器加速卡、OAM 板的高多层板、HDI 板等一系列核心产品，形成完整技术体系，其中“服务器主板用印制电路板”获评国家级制造业单项冠军产品、“用于高性能计算（HPC）的大 BGA 服务器主板”获广东省高新技术协会科技进步奖二等奖、“AI 服务器超高阶高多层复合基板项目”获得中国电子学会科技进步奖三等奖等。公司围绕各类型服务器印制电路板研发积淀多项核心技术，构建起自有知识产权体系，同时配套形成高精度量产制程能力，现阶段已成熟掌握背钻精度管控、超高厚径比电镀、精密阻抗匹配控制等关键工艺技术。综上，公司已具备较为坚实的技术积累，为本项目的顺利实施提供了技术基础。

3、良好的口碑及优质的客户资源保障本项目产能消化

公司凭借过硬的产品品质、同步研发能力与高效服务体系，已与全球头部服务器品牌及 EMS 厂商建立长久稳固的合作关系，合作范围覆盖全球前十大服务器制造商中的八家。凭借稳定的供货能力、及时的技术响应以及深度协同的新品开发服务，公司先后斩获“年度优秀供应商”“最佳供应商”“完美质量奖”等

多项荣誉，在 PCB 领域树立了良好的品牌口碑。同时公司持续拓宽客户边界，积极布局消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，客户群体多元化发展，合作关系较为稳定。综上，在行业内较好的客户口碑和优质的客户资源，为本项目产能消化奠定客户基础。

（四）项目备案及审批相关情况

本项目拟在广合科技已有场地实施，不涉及新增土地。截至本报告出具之日，相关手续尚在办理过程中。

（五）项目经济效益

经分析论证，本项目具有良好的经济效益。

二、高多层产线技术改造项目

（一）项目概况

本项目拟投资 155,992.17 万元，拟使用本次向不特定对象发行 A 股可转债募集资金 100,000.00 万元。本项目主要对原有产线开展技术改造，拟引进适配高多层板产品的高精度、高自动化新型设备及配套装置。本次改造完成后，将显著提升公司整体制造能力、产品品质与产品附加值，充分满足下游客户高端产品订单需求。本项目由广合科技实施。

（二）项目实施的必要性

1、顺应行业发展趋势，提升产品技术含量与附加值

当前国家大力培育和发展新质生产力，人工智能、6G 通信、云计算、大数据、智能网联汽车等新兴产业高速发展，为国内印制电路板行业带来重大发展机遇。AI 服务器作为算力核心整机设备，在 PCIe 6.0、NVLink、112G/224Gbps 等高速传输协议的迭代升级下，技术架构与配套组件持续演进，GPU 主板、AI 加速卡等关键硬件标准同步升级。对应搭载的高多层板各项技术指标日趋严苛，超细线路、深微孔、高精度阻抗控制等核心制造环节技术壁垒显著加深，同时对 PCB 板的层数、层间对位精度、多层压合工艺、层间导通稳定性等多高层板核心生产技术提出了极高要求，先进工艺与多高层板量产制造能力已成为行业竞争

的核心要素。

公司现有部分产线工艺偏传统，不仅在超细线路、深微孔、高精度阻抗控制等前沿制造环节存在明显短板，同时核心产能及工艺集中于中低层 PCB 板生产，多高层板生产能力存在不足，难以适配 AI 算力、高端通信领域高多层 PCB 板的量产及品质要求。因此，公司将配套引进先进生产制程及专用工艺设备，改善生产条件、提升工艺水平，实现 PCB 产品加工精度、运行稳定性与综合性能的优化。本项目实施后，公司可全面适配行业技术发展要求，提高高多层板等高端 PCB 产品占比，提升产品附加值和单价，扩大高多层板的生产能力。

2、淘汰老旧设备，提升产品品质

公司部分生产线投产运行年限较长，该等设备存在加工精度不足、运行稳定性弱化等问题，无法严格保障产品批次生产的一致性，直接造成了产品良率不稳定、生产损耗偏高。当前，下游服务器、高速通信、数据中心等高端领域头部客户，对 PCB 产品的加工精度、运行稳定性、批次统一性及全流程质量追溯能力制定了严苛的准入标准，高品质管控已成为企业进入核心供应链、维系长期战略合作的核心门槛。

本次技术改造将批量引入适配高多层板等高端产品生产的智能化、高精度生产及检测设备。项目实施后，可大幅提升核心生产工序的加工精度与标准化水平，有效提升产品生产良率、降低质量隐患与客诉风险，提升企业市场口碑与供应链竞争力。

3、强化核心客户配套能力，增强合作粘性

下游 AI 服务器、数据中心、高速通信等领域核心客户业务规模持续扩张、产品持续迭代，对上游 PCB 供应商的高端产能配套、稳定供货、品质保障及全周期服务能力要求持续提升。公司已与行业头部客户建立长期战略合作关系，但现有高端产能不足、配套体系有待完善，难以持续匹配核心客户的规模化、迭代化配套需求，不利于存量客户合作的稳定性与深度绑定。此外，当前高端 PCB 行业客户准入标准日趋严格，下游潜在优质客户在供应商筛选过程中，会重点考核企业高端产线配置、柔性生产能力、高端量产规模及技改升级潜力等因素，现

有产线短板一定程度上制约了公司拓展优质客户。

本项目实施后，一方面可进一步匹配现有核心客户的产品升级、产能扩容需求，具备持续、稳定、迭代式的高端供货配套能力；另一方面可有效满足新增优质客户的供应商准入考核标准，提升公司整体硬件实力与配套资质，为后续开拓高端新客户、拓展新的市场资源、优化客户结构奠定坚实基础。

（三）项目实施的可行性

1、产业政策利好，项目建设契合国家产业导向

近年来，国家持续推动电子信息产业高端化、自主化转型升级，多部委先后出台多项扶持政策，为本次项目建设创造了良好的政策环境。

2023年12月，“高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”被列入国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》；2025年9月，工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，提出加快人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设，同步强化整机与软硬件协同技术攻关；2026年1月，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。此外，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《印制电路板行业规范条件（2025年本）》《电子信息制造业数字化转型实施方案》《数字中国建设整体布局规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《算力互联互通行动计划》及《产业结构调整指导目录（2024年本）》等多项配套政策从多个维度支撑本行业健康稳定的发展。

2、管理体系完善，项目具备较好的管理基础

公司高度重视生产经营过程中的精细化管理与成本管控工作，长期深耕PCB制造领域，已建立成熟完善的生产经营管理体系。公司持续推行精益生产与降本增效管理模式，搭建了综合成本独立核算及评价体系，并配套建立系统化的数据收集、分析及考核激励机制，具备较强的成本控制与精细化运营能力。

公司建立了覆盖全业务链条的质量管理体系，严格按照体系要求制定供应商认证、物料检验、生产过程管控、订单管理及客户服务等全流程管控规范，并通过常态化内部审查与稽核机制，实现质量管理体系的有效落地与持续优化。同时，依托 ERP 数字化管理系统，公司可对物料采购、生产制造、检验入库、产品发货各环节进行全程数据记录与动态追溯，为生产管控、质量分析与工艺优化提供可靠的数据支撑。

3、优秀的团队为本项目提供人才支撑

公司组建了一支优秀精干的核心管理、生产与技术团队，核心成员均深耕 PCB 行业多年，在市场研判、技术研发、生产管控、品质管理等领域积淀深厚，精准把握行业发展规律与市场动态，可结合客户需求高效推动新技术、新产品落地应用。

公司研发人才队伍持续扩容、梯队结构不断优化。截至 2025 年末，公司研发人员规模达 530 人，占员工总人数比例为 10.60%，较上年同比增长 35.55%。同时公司建立了完善的人才培养、绩效考核与激励约束体系，具备灵活的人员调配能力，可从现有成熟生产基地抽调业务骨干指导本项目的建设和运营。

（四）项目备案及审批相关情况

本项目拟通过租赁场地实施，不涉及新增土地。截至本报告出具之日，相关手续尚在办理过程中。

（五）项目经济效益

经分析论证，本项目具有良好的经济效益。

三、补充流动资金

（一）项目概况

公司综合考虑了发展现状、经营战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金中的 75,000.00 万元用于补充流动资金（占公司本次发行募集资金总额的 20.83%），

以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

（二）补充流动资金的必要性

本次募集资金投资项目顺利建成并投产运营后，公司产能规模将得到有效扩充，整体生产运营能力实现提质升级。随着产能释放与业务规模持续扩张，公司日常生产经营、原材料采购、订单交付等环节的营运资金占用将持续增加。同时，为稳固并进一步提升公司核心竞争力，持续跟进行业前沿技术迭代趋势，公司需持续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，不断完善产品体系、优化产品性能，持续巩固行业市场地位。

基于公司未来业务扩张、技术创新及市场拓展的整体发展规划，公司整体资金储备及资金实力面临更高的匹配要求。本次通过补充流动资金，能够精准覆盖公司关键环节的资金缺口，有效缓解业务发展过程中的资金压力，持续提升公司产品核心竞争力与综合经营实力，夯实公司规模化、高质量发展的业务基础，为公司中长期稳健经营、持续扩张筑牢资金保障，本次项目实施具备充分的必要性与合理性。

（三）补充流动资金的可行性

本次公司发行证券募集资金用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等境内监管法律法规及行业规范性文件的相关要求，募集资金用途合规、程序合法，项目实施具备充分的政策可行性。

公司自成立以来，持续完善现代化企业经营管理体系，已构建规范健全的法人治理结构、完善的内部控制制度及标准化的经营管理机制，形成了权责清晰、管控到位、运行高效的公司治理格局与内控环境，能够为本次募集资金的规范使用提供完善的制度支撑与管理保障。

针对募集资金管理工作，公司已严格参照监管规则制定专项募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用审批、投向管理、监督核查等关键事项作出了全面、细化的制度化规定。本次募集资金足额到位后，公司将严格遵守国家相关法律法规、监管规范性文件及内部管理制度要求，对募集资金实行专户管理、专款

专用，规范履行资金使用审批流程，全程强化募集资金使用管控与监督，切实保障全体投资者的合法权益，确保募集资金合规、高效、合理使用，助力公司持续稳健发展，本次项目实施具备充分的可行性。

第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

一、本次向不特定对象发行可转债对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司在算力服务器领域的核心竞争力进一步增强，国际地位和业务规模持续提升，有利于提高公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展，助推公司实现“打造智能互联领域的全球领导者”的愿景目标。

二、本次向不特定对象发行可转债对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，如本次发行的可转债逐渐转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，抗风险能力将得到提升。

新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转债转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。

第四节 可行性分析结论

本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有重要意义。项目顺利实施后，将进一步提升公司的市场竞争力和盈利水平，符合公司长期发展需求及全体股东利益。公司本次发行 A 股可转债募集资金运用具有较好的必要性及可行性。

广州广合科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日